

PA-1450-33HS SPECIAL ASSEMBLING INSTRUCTION

REV:A

一. 安規要求：	<i>膠類料號</i>
1.1 T050與PCB之間須點散熱固定RTV膠，勿過量超出PCB限制區 (圖1)	753961
1.2 DIP位置須點導熱固定RTV膠，點膠量務求均勻. (圖2)	753961
1.3 SMD位置須點導熱固定RTV膠，點膠量務求均勻. (圖3)	753961
1.4 點膠量務求均勻，總點膠量為16+/-2g < min >	
1.5 為避免C054在10N力後會碰觸case, C054需要確實被膠包覆，不可傾倒向case	753961
二. 客戶要求：	<i>膠類料號</i>
2.1 零件剪腳後需全部補焊.	
2.2 補焊後需清除錫球,且須使用放大鏡全檢是否殘留錫球.	
三. 設計性要求：	<i>膠類料號</i>
3.1 T050, C204, F001, C001 須和 PCB 緊貼,使之不可浮件及歪斜.	
3.2 PCB SMD 零件及出腳, 腳長不得超過 2.5 mm.	
3.3 上Case內側貼附鋁套及FRPP於此位置 (圖4)	
四. 其他要求：	<i>膠類料號</i>
4.1 組裝CASE時, 先裝下蓋, 再裝上蓋.	
4.2 中縫標準為0.4 +0.25 / - 0.2mm	

Prepared by:

Checked by:

Approved by:



圖1. T050與PCB之間須點散熱固定RTV膠，勿過量超出PCB限制區



圖2. 以上零件間須點散熱固定RTV膠_753961

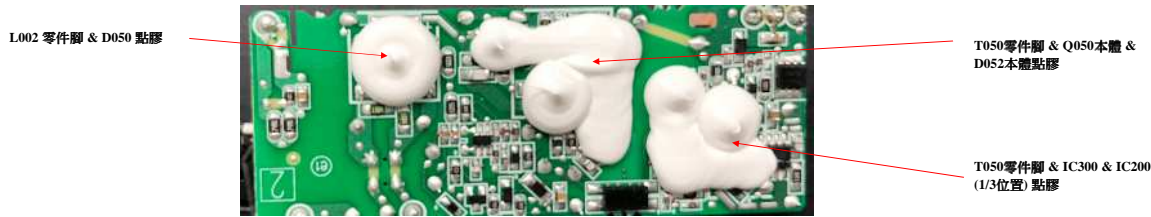


圖3. 以上SMD零件腳，須點散熱固定RTV膠_753961

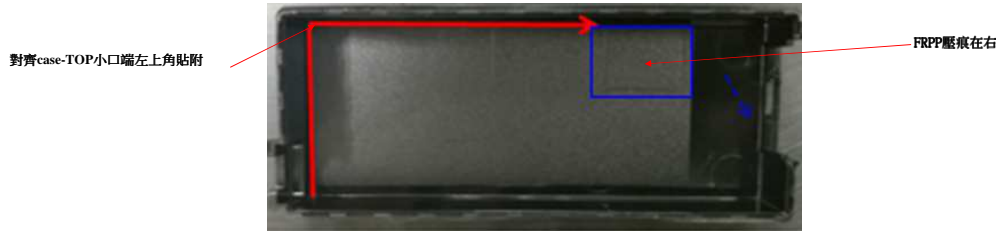


圖4. 參照上圖，Case-TOP內側貼附鋁套及FRPP於此位置

H1	Adaptor height	27.05
1	case	1.50
2	中縫	0.40
3	shield-TOP(上FRPP和上鋁套為一體)	0.65
4	PCB上至T050	19.00
5	PCB板下至FRPP	2.50
6	下FRPP	0.45
7	shield-BTM	0.35
8	case	1.50
9	機芯高度	22.95
10	內空尺寸	24.05